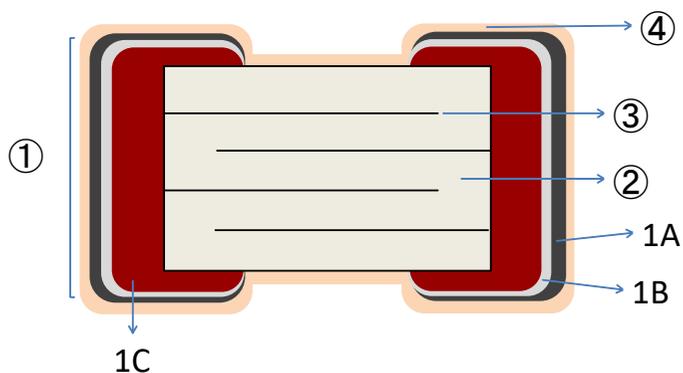


## チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表 Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<GXM/GXT/GGM Series>

### 1.内部構造/Structure



### 2.材料名/Material

No.	名称/Name		材料/Material
①	外部電極 Termination		
	1A	めっき層 Plated layer	すず Tin
	1B	めっき層 Plated layer	ニッケル Nickel
	1C	下地電極 Electrode	銅 Copper
②	誘電体素子 Dielectric layer	温度補償用(Class1) Temperature compensating type(Class1)	ジルコン酸カルシウム系 Calcium zirconate-based
		高誘電率系(Class2) High dielectric constant type(Class2)	チタン酸バリウム系 Barium titanate-based
③	内部電極 Inner electrode		ニッケル Nickel
④	撥水膜 Waterproof film		シランカップリング剤 Silane coupling agent

J(E)MCZ0-1R0819C

<ご参考> 当社ウェブサイトにて、各シリーズの最新の構造図を入手いただくことが可能です。 → [構造図/材料表](#)

<Reference> The latest structure diagrams of each series are available on our website. → [Structure diagram, Materials chart](#)